

CLAYTEC Korkausbauplatte dünn

Cellco Korkdämm-Platte (EKP)

Art. 09.510: D 10 mm

Anwendungsgebiet Korkausbauplatte als Putzträger im Holzbau für CLAYTEC Lehmputze.

Zusammensetzung Expandierten Naturkork ohne Zusatzstoffe.

Baustoffwerte Rohdichte ca. 120 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, μ 24-29, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 Euroklasse E

Maße B= 0,50 m, L= 1,00 m, D= 10 mm.

Lieferform Pakete auf Paletten. D 10 mm: Paket 15,0 m², 14 Pakete/Palette = 210,0 m².

Lagerung Tocken und luftig lagern, nicht unter Folie. Bei Transport und Lagerung sorgfältig vor Nässe und Schwitzwasser schützen.

Materialbedarf Bei der Ermittlung des Materialbedarfs Reserve von ca. 10% für Verschnitt etc. berücksichtigen.

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber (Holzwerkstoffplatten staubfrei), frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. Fehlstellen grob ausbessern. Sandene Untergründe ggf. mit CLAYTEC Tiefengrund und Festiger fixieren.

Verarbeitung Feuchtebeanspruchungen aus nass eingebauten Putzen und Estrichen sind nicht zulässig, allgemein darf die rel. Luftfeuchte bei Lagerung und nach dem Einbau 70% nicht übersteigen. Der Feuchteintrag durch Verklebung oder Verputz ist so niedrig wie möglich zu halten.

Die Platten werden mit der Stichsäge, der Kreissäge oder mit dem Cuttermesser geschnitten.

Die unterste Plattereihe wird mit etwas Abstand („Luft“) zum Boden eingebaut.

Die Platten werden ohne Klebung mit CLAYTEC Lehmbauplattenschrauben 5 x 50 mm, WÜRTH Schnellbauschrauben mit Grobgewinde oder KNAUF Universalschrauben FN befestigt, Schraubenstand ca. 20 cm, bei nachfolgender Dicklagenbeschichtung enger. Als Klammern sind z. B. BEHRENS (BEA) 155/18_NK_HZ, Art.-Nr. 10002009, oder artgleich geeignet. Klammerabstand ca. 12 cm, Randabstand 10-15 mm.

Im Bad sind immer rostfreie Befestigungsmittel zu verwenden.

Die Fortführung von Wandöffnungsbegrenzungen durch horizontale oder vertikale Fugen ist unzulässig. Die Verarbeitung der Platten erfolgt mit um mind. 20 cm, besser 30 cm versetzten Stößen.

Weiterbehandlung Spalte \geq 1 mm Breite ggf. mit CLAYTEC Lehmklebe- und Armierungsmörtel oder Lehm-Oberputz fein 06 ausspachteln und trocknen lassen. Platten sorgfältig entstauben.

Dünnlagenbeschichtung: Die Flächen werden 3 mm dick mit Lehmklebe- und Armierungsmörtel überzogen. Er kann auch mit der Putzmaschine angespritzt werden, Ruhezeiten sind bei dieser Anwendung nicht notwendig. In die noch nasse Oberfläche wird Glas- oder Flachsgewebe flächig eingearbeitet. Nach Trocknung YOSIMA Lehm-Designputz fachgerecht auftragen. Für das YOSIMA Lehm-Farbspachtelsystem oder das CLAYFIX Lehm-Anstrichsystem Armierungslage sehr sorgfältig ausführen (= Schraublöcher und Vertiefungen vorab schließen und Stellen trocknen lassen), besser dünn mit Lehm-Oberputz fein 06 verputzen.

Dicklagenbeschichtung: Die Flächen werden mit der Grundierung DIE ROTE vorbehandelt. Lehm-Unterputz Stroh, Lehmputz Mineral 20 oder SanReMo in einer Lagendicke max. 8 mm auf Wandflächen und max. 5 mm auf Decken- oder Dachschrägenflächen auftragen. In die noch nasse Oberfläche wird Glas- oder Flachsgewebe flächig eingearbeitet. Trocknen lassen. Gesamtputzaufbaudicke Wand max. 15 mm, Decken- oder Dachschrägen max. 10 mm (jeweils mind. zweilagig).

Wandflächenheizung: Vorbereiten der Flächen mit der Grundierung DIE ROTE oder mit Zahnpachtelung aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel. Trocknen lassen. Vorspritz bis max. 8 mm mit einem der o.g. Lehmputzmörtel. Nach Trocknung Auffüttern bis Rohrscheitel Wandheizung. Trocknung des gesamten Unterputzes mit Heizungsunterstützung. Weiteres siehe CLAYTEC Arbeitsblatt Lehmputze.